



Final Product/Process Change Notification

Document #:FPCN22807X

Issue Date:17 Apr 2020




Title of Change:	To add Pactech Malaysia as e-NiPd pad plating site and UTAC Thailand as assembly site for Common Mode Filter devices in DFN package		
Proposed First Ship date:	24 Jul 2020 or earlier if approved by customer		
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Mike.Begonia@onsemi.com		
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or PCN.samples@onsemi.com Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.		
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Francis.Lualhati@onsemi.com		
Type of Notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact PCN.Support@onsemi.com		
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Date code marking as identifier of site code		
Change Category:	Assembly Change		
Change Sub-Category(s):	Manufacturing Site Addition, Manufacturing Process Change, Material Change		
Sites Affected:			
ON Semiconductor Sites		External Foundry/Subcon Sites	
ON Semiconductor Seremban, Malaysia		ATP3, Philippines	
		Pactech, Asia	
		UTAC, Thailand	
Description and Purpose:			
<p>This notification announces to customers to have Pactech Malaysia as additional e-less NiPd pad plating site, while UTAC Thailand as additional assembly site for Common Mode Filter devices in DFN package. Both additional sites are ISO/TS16949:2009-certified and have already been qualified and utilized by ON Semiconductor.</p> <p>Products will continue to be Pb-Free, Halide free and RoHS compliant. Qualification tests were designed to show that the reliability of the qualified devices would continue to meet or exceed ON Semiconductor standards. The assembly location site can be identified through the date code marking.</p>			
	Before Change Description	After Change Description	
Assembly Site	Amkor Philippines	Amkor Philippines	UTAC Thailand
Lead Frame	PPF Lead frame	PPF Lead frame	PPF Lead frame
Die Attach	ELASTOMER NEX-130CTX 8" Non UV	ELASTOMER NEX-130CTX 8" Non UV	HR5104
Bond Wire	0.8 Au Wire	0.8 Au Wire	0.8 Au Wire
Mold Compound	MC EMC, G700Y (14*5.1)	MC EMC, G700Y (14*5.1)	G700LTD
Other Changes	FCMS eNiAu Pad Plating	FCMS eNiAu Pad Plating	Pactech eNiPd Plating



Final Product/Process Change Notification

Document #:FPCN22807X

Issue Date:17 Apr 2020

	From	To
Product marking change: M – one digit date code	Date code marking Amkor Philippines 	Date code marking Amkor Philippines  UTAC Thailand 

Reliability Data Summary:

QV DEVICE NAME: SZEMI8133MUTAG

RMS: S59540

PACKAGE: XDFN 16 3.5 * 1.35* 0.4P

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	Ta= 150°C, 100% max rated V	1008 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc	0/231
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs	0/231
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/90
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec		0/45

Electrical Characteristics Summary:

Available upon request

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
EMI8041MUTAG	SZEMI8133MUTAG
EMI8042MUTAG	SZEMI8133MUTAG



Final Product/Process Change Notification

Document #:FPCN22807X

Issue Date:17 Apr 2020

EMI8043MUTAG	SZEMI8133MUTAG
EMI8131MUTAG	SZEMI8133MUTAG
EMI8132MUTAG	SZEMI8133MUTAG
EMI8133MUTAG	SZEMI8133MUTAG
EMI8141MUTAG	SZEMI8133MUTAG
EMI8142MUTAG	SZEMI8133MUTAG
EMI8143MUTAG	SZEMI8133MUTAG

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22807X

発行日: 17 Apr 2020

変更件名:	Pactech Malaysia (マレーシア) を e-NiPd パッドメッキ拠点として、UTAC Thailand (タイ) を DFN パッケージのコモンモード フィルター製品の組立拠点として追加
初回出荷予定日:	24 Jul 2020 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前.
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または mike.begonia@onsemi.com にお問い合わせください。
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または Francis.Lualhati@onsemi.com にお問い合わせください。
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。 お問い合わせは、<PCN.Support@onsemi.com> 宛てにお願いします。
変更部品の識別:	拠点コードの識別子としての日付コードのマーキング

変更カテゴリ: アセンブリの変更

変更サブカテゴリ: 製造拠点の追加, 製造プロセスの変更, 材料の変更,

影響を受ける拠点:

オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:
ON Semiconductor Seremban, Malaysia	ATP3, Philippines
	Pactech, Asia
	UTAC, Thailand

説明および目的:

本通知は、Pactech Malaysia (マレーシア) を e-less NiPd パッドメッキ拠点として、そして UTAC Thailand (タイ) を DFN パッケージのコモンモードフィルター製品の組立拠点として追加することをお知らせするものです。追加拠点は両社ともに、ISO / TS16949:2009 認証されています。両社は、オン・セミコンダクターによって既に認定され、活用されています。

これらの製品は継続して鉛フリー、ハロゲン化合物フリーであり、RoHS に適合しています。認定試験は、認定された製品の信頼性が引き続きオン・セミコンダクターの基準以上となることを確認できるように設計されています。組立拠点の場所は、日付コードのマーキングによって識別できます。




	変更前の表記	変更後の表記	
組み立て拠点	Amkor Philippines	Amkor Philippines	UTAC Thailand
リードフレーム	PPF Lead frame	PPF Lead frame	PPF Lead frame
ダイ接着剤	ELASTOMER NEX-130CTX 8" Non UV	ELASTOMER NEX-130CTX 8" Non UV	HR5104
ボンドワイヤー	0.8 Au Wire	0.8 Au Wire	0.8 Au Wire
モールド・コンパウンド	MC EMC, G700Y (14*5.1)	MC EMC, G700Y (14*5.1)	G700LTD
その他の変更	FCMS eNiAu Pad Plating	FCMS eNiAu Pad Plating	Pactech eNiPd Plating



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22807X

発行日: 17 Apr 2020

	変更前	変更後
製品表示変更: M-1 桁の日付コード	日付コードのマーキング <i>Amkor Philippines (フィリピン)</i> 	日付コードのマーキング <i>Amkor Philippines (フィリピン)</i>  <i>UTAC Thailand (タイ)</i> 

信頼性データの要約:

デバイス名: SZEMI8133MUTAG

RMS: S59540

パッケージ: XDFN 16 3.5 * 1.35 * 0.4P

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta= 150°C, 100% max rated V	1008 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc	0/231
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs	0/231
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/90
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec		0/45

電気的特性の要約:

電気的特性の提出は要求に基づきます。

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
EMI8041MUTAG	SZEMI8133MUTAG
EMI8042MUTAG	SZEMI8133MUTAG
EMI8043MUTAG	SZEMI8133MUTAG
EMI8131MUTAG	SZEMI8133MUTAG



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22807X

発行日: 17 Apr 2020

EMI8132MUTAG	SZEMI8133MUTAG
EMI8133MUTAG	SZEMI8133MUTAG
EMI8141MUTAG	SZEMI8133MUTAG
EMI8142MUTAG	SZEMI8133MUTAG
EMI8143MUTAG	SZEMI8133MUTAG